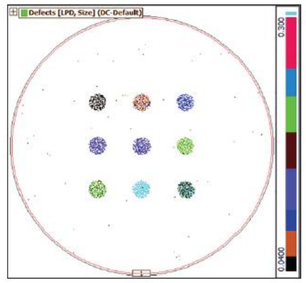
MSP社製パーティクル塗布サービスの概要

①　パーティクルの種類

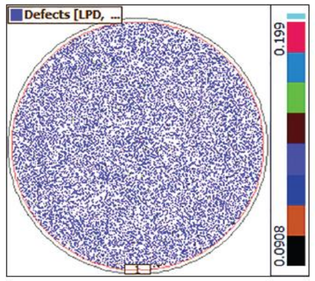
PSL粒子
SiO2粒子
その他の粒子（AlF3, Al2O3, Ni, Ru, Si, Si3N4, Sn, Ti, Ta, TiN, TiO2, W, Y2O3）

②　塗布パターン



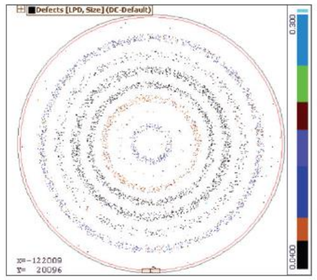
Spot Deposit

スポット塗布



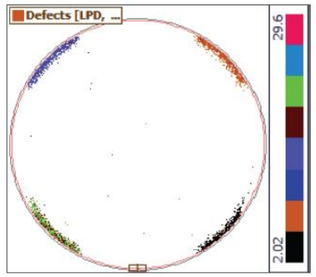
Full Deposition

全面塗布



Ring Deposition

リング塗布



Edge and Arc Depositions

エッジ・アーク塗布

③　パーティクルのサイズ

標準：20nm~1,600nm (PSL、SiO2)
20nm未満（10~19nm）及び1,600nmよりも大きい粒径（PSLは20,000nmまで、SiO2は16,000nmまで）をご希望の場合が、追加費用が掛かります。
その他の粒子については、別途ご相談となります。

④　塗布個数

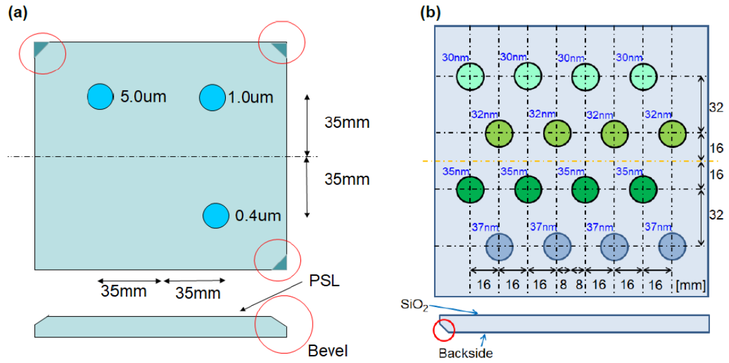
標準：400個～25,000個（スポット、リング、エッジ・アークあたり）
標準：400個～50,000個（全面あたり）
上記よりも多い塗布個数をご希望の場合は、追加費用が掛かります。

⑤　スポット径

標準：Φ15～35mm
上記よりも大きい径をご希望の場合は、別途ご相談となります。
リング及びエッジ・アーク塗布の幅についても、標準は上記のとおりとなります。

⑥　塗布基板	MSP社支給	お客様支給
ウェハ (150mm, 200mm, 300mm)	Bare Silicon (Si) Notched	Bare Silicon (Si) Film Patterned
フォトマスク (6" x 6" x 1/4")	Blank Optical	Blank Film Patterned Optical EUV

フォトマスクへの塗布の一例



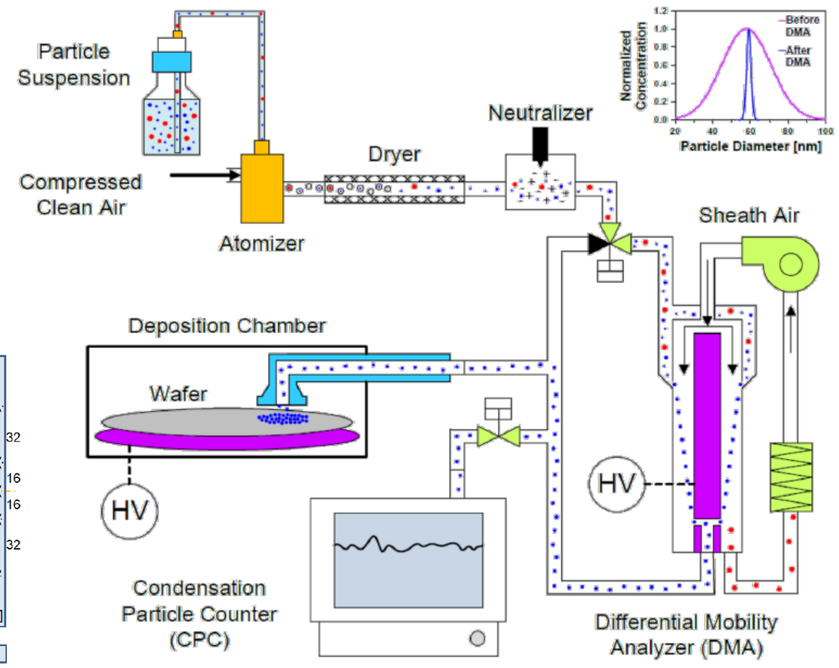
その他

塗布個数の精度は±30%となります。　（例：塗布個数1,000±300個）
スポット径の精度は±20%となります。（例：Φ25±5mm）
ご希望であれば200mmカセット、300mmFOSBも提供可能です。

納品時には基板と併せて下記書類を提出致します。
・塗布した粒子の証明書
・KLA Tencor社製ウェハ検査装置SP2でのスキャン結果
(フォトマスクへの塗布の場合は、同レシピをダミーウェハに塗布し、それをスキャンした結果)

左記の①～⑥に加え、スポット個数と基板枚数をご連絡頂ければ御見積もり可能です。
納期は受注後、または塗布基板がMSP社に到着後3~4ヶ月となります。

MSP社製パーティクル塗布装置の原理



お問い合わせ先
株式会社GSIクレオス　半導体エレクトロニクス部　営業課　雨宮 新（あめみや しん）
e-mail: s.amemiya@gsi.co.jp　　Tel: 070-7591-9895